谷口昌平\*1) 北原明治\*2) 若山修一\*3) 江里口映子\*4) 陶山直樹\*4)

Mechanism of surface hardening on dual ion implanted metals

Shohei TANIGUCHI, Akiharu KITAHARA, Shuichi WAKAYAMA, Eiko ERIGUCHI and Naoki SUYAMA

Abstract The dual implantation of silicon and carbon ions into copper, iron and SKD11 were carried out with a MeV ion accelerator. Analysis by transmission electron microscopy revealed that the ion implanted layer of a Cu substrate is crystalline, while that of an Fe substrate is amorphous. The hardness was measured as a function of the depth by a continuous stiffness measurement method with a nano indenter. Dual ion implantation was found to enhance the hardness of a substrate, and the peak hardness occurred at a smaller depth than the peak concentration of the implanted layer. Cross-sectional transmission electron microscope images of ion implanted layers, taken under the indentations with various depth, showed that the indenter did not fracture the implanted layer, but rather deformed it plastically. These data provide us with a qualitative understanding of the hardness.

Keywords Dual ion-implantation, Si ion, C ion, SiC, TEM, FIB, Nano-indentation

## 1.はじめに

イオン注入法は,熱処理を伴わずに,任意のイオンを 添加する技術として知られている。イオンの添加やイオ ンエネルギーの効果により,表層に化合物層の形成や結 晶構造の変化を引き起こし,耐摩耗性などを向上させる ことが可能であることから,表面改質に応用されている。

イオン注入による表面改質は, 剥離や寸法変化が極め て少なく, また熱処理を必要としないので, 最終寸法を 変えずに表面特性を改善する方法として知られている。

表面改質に用いられるイオンのエネルギーは,数 10keVから200keVの報告例が多い。MeVのオーダーに エネルギーを高くすると,表面におけるスパッタリング の影響を少なくでき,表面の後退や粗れを抑えることが 可能である。また,イオンを深い位置に注入でき,埋め 込み層が形成できるという特長がある。このため,イオ ン通過層,イオン注入層,素地が分離できるので,各層

\*<sup>1)</sup>放射線応用技術グループ

- (現城南地域中小企業振興センター)
- \*<sup>2)</sup>放射線応用技術グループ
- \*"東京都立大学大学院工学研究科
- \*4)財団法人材料科学技術振興財団

の評価が従来よりも明確にできることが予想される。

従来から,改質効果の一つとして,表面硬さの向上が 報告されており,その原因として,基板種とイオン種の 組み合わせにより異なるが,窒化物などの硬質化合物の 形成や表層の結晶構造変化などの影響が挙げられている。 しかし,硬さ試験において,圧子挿入時にイオン注入層 がどのような挙動を示すかを直接観察した例は,著者が 調べた限りない。イオン注入層の挙動が解明できれば, イオン注入による硬さ向上のメカニズムが明らかになる と考えられる。

筆者らは、シリコン(Si)イオンとカーボン(C)イオン を金属基板へ二重イオン注入することにより、硬質セラ ミックスである炭化ケイ素(SiC)層を金属表層に形成し、 表面硬さを向上させる試みを行ってきた<sup>14)</sup>。その結果、 X線光電子分光分析(XPS)により、SiC 結合を確認した が、金属種により形成の割合が異なることも明らかにし た。ここでは、イオン注入層の結晶構造の解析を行うと 共に、ナノインデンテーションにより、硬さの深さ方向 分布を測定し、圧痕下におけるイオン注入層の挙動を明 らかにするために、圧痕直下の断面 TEM 観察を行った。 さらにイオン注入試料の耐摩耗性についても報告する。

# 2. 実験方法

試料は,直径 30mm,厚さ 5mm の Fe(99.9%),Cu (99.9%)及び SKD11 材を用い,1µmダイヤモンド粒に よる鏡面研磨後,アセトンにより超音波洗浄し水冷サン プルホルダーに設置した。2種類のイオンを同一基板上 に,エネルギーをSi:1.5MeV,C:1.2MeV,注入量を それぞれ,1×10<sup>18</sup> ions/cm<sup>2</sup> でSi,Cの順でイオン注入し た。エネルギーは,SiC 形成を意図しているので,Si と C が等しい深さに注入されるように,シミュレーション (TRIM コード)により計算し選択した。注入量は,金属 の硬さ向上には10<sup>17</sup> ions/cm<sup>2</sup> 以上の注入量が必要とされ ているのでこの量を選択した。イオン注入は,タンデム 型イオン加速器(HVEE 社)で行い,イオン源はセシウム スパッタ型イオン源を用いた。イオンの場合は,グラ ファイト粉末を用いた。

イオン注入試料の結晶構造をイオン通過層,イオン注入層,素地(イオン注入層の下部)の各領域ごとに明らかにするために,収束イオンビーム装置(FIB)により薄片試料を作製し,断面 TEM 観察及び電子線回折を行った。

硬さの評価は, 試料に Fe, Cu を用い, バーコビッチ 圧子の押込試験機ナノインデンター(MTS 社)により測 定した。測定は, 深さ方向の硬さ分布が得られる CSM<sup>5)</sup> モードで行った。さらに, 圧痕下のイオン注入層の挙動 を断面 TEM により観察した。また, Fe 試料について は, 圧痕下における Fe の結晶性を電子線回折で評価 した。

耐摩耗性の評価は, Fe, Cu などの純金属よりも,工 具鋼を用いる方が適切と考え,試料に SKD11 材を用い た。試験は,ボール・オン・ディスク摩擦摩耗試験機に より測定した。注入条件は, Fe, Cu 試料と同条件で行 い,摩擦試験は,荷重 5 N,摩擦速度 1 回転/sec,摩擦 半径 5mm,アルミナボールの条件で 3000回転まで行っ た。 1000回転ごとに摩耗トラックの断面積を表面粗さ 計により測定し摩耗量を評価した。

## 3.実験結果および考察

Fig.1 に Cu 試料の断面 TEM 像および電子線回折パタ ーンを示す。イオン注入層は表面から深さ約1µmを中 心に分布しており,回折線から,イオン注入層は結晶性 で,イオン通過層の結晶粒は素地よりも微細化していた。 以前報告した Fe 試料および SKD11,SUS304のイオン 注入層はアモルファスであった<sup>3,4)</sup>ので,イオン注入層は 基板種により結晶になる場合とアモルファスになる場合 があることが示された。これは,組成および融点などに 起因するものと考えられるが<sup>®)</sup>,明らかになっていない。 回折像から,のイオン通過層は Cu 結晶,のイオン 注入層上部が CuSi 及び CuteSi4 結晶,のイオン注入層 下部が CuteSi4 結晶,の素地が Cu 結晶であることが明 らかになった。また,X線回折で解析した結果<sup>2)</sup>では, グラファイトおよびシリコン結晶が確認されたが電子線 回折では確認できなかった。



Fig.1 Cross-sectional TEM image and electron diffraction pattern of implanted Cu sample.

Fig.2 に Fe および Cu 試料における深さ方向の硬さ分 布と TRIM コードによりもとめた Si+C イオンの濃度分 布を示す。硬さのピーク深さは,0.5 µm以下で,注入イ オンの濃度ピーク深さ約 1 µmよりも浅い領域に現れた。 これは,硬さ測定では,圧子先端直下の試料硬さだけで なく,圧子先端からある深さまでの硬さが寄与するため に,圧子がイオン注入層に達する前に,高い硬度を示し たと考えられる。



Fig.2. Depth profiles of hardness of implanted Cu (), unimplanted Cu ( - - - ), implanted Fe (), and unimplanted Fe ( - - - ). The concentration of Si + C ions in Cu () and Fe() is also indicated.

Fig.3 に Fe 試料の圧痕下の断面 TEM 像および電子線 回折パターンを示す。Fig.3(a)は,圧痕先端の深さが, A=0.18 µm, B=0.38 µm, の時の像である。A では, イ オン注入層の変形は見られないが, B では, わずかにイ オン注入層に凹型の変形が見られた。Fig.3(b)に示す電 子線回折像から、イオン通過層 および素地 は結晶性 を示し,イオン注入層 はアモルファス層であった。イ オン通過層 では,素地 と比較すると Cu 試料と同様 に結晶粒が微細化していた。このことから,高速イオン が通過した領域では、再結晶が起こり、結晶粒が微細化 すると考えられる。圧痕下 では,回折スポットの 伸びが確認でき,格子の歪みが示唆された。スポットの よりも圧痕直下である , の方が顕著に現 伸びは, れているので,圧子により押し込まれる過程で,格子の 乱れが生じていることが示唆された。このことから、イ オン通過層がイオン注入層と圧子との間で圧縮されてい ると考えられる。





(b)Electron

(a) Cross-sectional TEM image.
 Indentation depth :
 A 0.18 μm, B 0.38 μm

diffraction pattern

Fig.3 Cross - sectional TEM image and electron diffraction pattern of indentation for Fe sample.

Fig.4 にさらに圧子を深く押し込んだ時の Fe 試料の断面 TEM 像を示す。イオン注入層は圧子の先端が深く基板に押し込まれるに従い,変形していくことが示された。 イオン注入層は湾曲をしたが,TEM 像からはクラックは観察されなかった。

Fig.5 に Cu 試料の場合を示す。Fe 試料と同様に押し 込み深さが浅い Fig.5(a)の場合は,イオン注入層に変形 は見られず,押し込み深さが深くなる Fig.5(b)の場合は, 変形が見られた。変形後の像からイオン注入層に Fe 試 料とは異なり,クラックが観察された。アモルファスは, 多軸応力下では著しい塑性変形を起こす<sup>7)</sup>ために,クラ ックが発生せず,Cu 試料のイオン注入層は結晶性であ るために結晶粒界からクラックが生じたものと考えられ た。



Fig.4 Cross-sectional TEM images of indentation in ion implanted Fe substrate. The indentation depth are (a)  $1.2 \ \mu$ m, and (b) $2.1 \ \mu$ m.



Fig.5 Cross-sectional TEM images of indentation in ion implanted Cu substrate. The indentation depth are (a)  $0.3 \,\mu$ m, and (b) 2.2  $\mu$ m.

Fig.6(a)に明らかになった未注入およびイオン注入試料の硬さの深さ方向分布と、イオン注入層の濃度分布を示し、このときの圧子による変形領域(硬さに寄与する領域)を Fig.6(b)に示す。これらの関係を Stage A - Dの領域に分け、それぞれの特徴を以下に示す。



Fig.6 Schematic representation of the contribution of the ion implanted layer to enhancing the hardness. (a) Depth profiles of the hardness of ion implanted ( ) and unimplanted ( ) Fe substrates, and concentration of Si + C ions (solid line). (b) Schematic representation of the deformation process during indentation for unimplanted (right) and ion implanted (left) materials. The black area indicates the region of plastic deformation. 東京都立産業技術研究所研究報告 第4号(2001)

1) Stage A:ここでは,圧子による変形領域は小さく, イオン注入層に達していない。そのために硬さは未注入 試料と等しい。しかし,実際にはイオン通過層では,結 晶の微細化が起こっているために,硬度はイオン注入に より上昇していた。

(2) Stage B: 変形領域がイオン注入層に達しているが, イオン注入層の変形は観られない段階で,硬さの最大値 を示す。イオン通過層は圧縮され,結晶に歪みが生じて いる。

(3) Stage C: 変形領域が大きくなり,イオン注入層が変形し始める。イオン注入層の変形が始まると硬さは下がり始める。

(4) Stage D:イオン注入層が大きく変形し,硬さは未注 入試料と等しくなる。Fe 試料で形成されたアモルファ スのイオン注入層ではクラックが発生せず破壊は起こっ ていないが,Cu 試料で形成された結晶性のイオン注入 層には,クラックが発生する。

以上の様に,硬さ測定の結果と断面 TEM 像から,イ オン注入層の変形が少ない圧子深さまで硬さの上昇が観 られ,イオン注入層が変形し始めると硬さが減少し, Fe,Cu 試料共に,圧痕深さ約2 µmでは,イオン注入試 料の硬さは,ほぼ未注入試料と等しくなることが明らか になった。

Fig.7(a)にボールオンディスク摩擦摩耗試験機により 測定した SKD11 のイオン注入試料,未注入試料の摩耗 トラック断面積と回転数の関係を示す。この結果から, イオン注入により耐摩耗性が向上することが明らかにな った。Fig.7(b)に断面プロファイルからもとめた摩耗ト ラックの深さを示す。イオン注入試料では,イオン注入 層上部までは 1000 回転の段階ですでに摩耗していたこ とが明らかになった。しかし 3000 回転でも摩耗はイオ ン注入層上部までで止まっており,それ以上,深くはな らなかった。このことから,イオン注入層により摩耗の 進行が妨げられていることが示唆された。



(a) Area of wear track

 Fig.7 Area and depth of wear track on implanted and un-implanted SKD11 samples.
 : Un-implanted,

 :Si1.5MeV,1x10<sup>18</sup>ions/cm<sup>2</sup> + C1.2MeV, 1x10<sup>18</sup>ions/cm<sup>2</sup>

(b)Depth of wear track

4.まとめ

金属材料に Si+C 二重イオン注入を行い, 断面 TEM 観察, 硬さ試験, 摩擦摩耗試験の結果,以下の結果を得 た。

(1) 2 重イオン注入により, Fe 試料の場合はアモルフ ァス, Cu 試料の場合は結晶性のイオン注入層が形成さ れていることが明らかになった。また,イオン通過層で は,結晶の微細化が観察された。

(2) 硬さ試験により,硬さの深さ方向分布を測定し, 圧痕下の断面 TEM 観察を行った結果,硬さ向上に寄与 するイオン注入層の挙動が明らかになった。

(3)二重イオン注入により耐摩耗性が向上することが明 らかになった。

#### 謝 辞

硬さ測定にご協力頂いた,株式会社東陽テクニカの青 木清氏に深く謝意を表します。

#### 文 献

- 谷口昌平,橘高雷太,北原明治:東京都立アイソトープ 総合研究所研究報告,14,49 (1998).
- S. Taniguchi, A. Kitahara and S. Wakayama: Materials Transactions, JIM, 40, 428 (1999).
- 3) 谷口昌平,北原明治,若山修一,江里口映子,陶山直樹:東京都立産業技術研究所研究報告,3,95 (2000).
- S. Taniguchi, A. Kitahara, S. Wakayama, E. Eriguchi and N. Suyama: Nucl. Instr. and Meth., 175/177, 647 (2001).
- 5) Mechanical Testing by Indentation Course Notes, NANO Instruments, Inc. (1997).
- 6) 渡辺徹:表面技術,40,375(1989).
- 7) 增本健:機械技術別冊,9月,20 (1987).

(原稿受付 平成13年8月1日)